

热烈庆祝光力科技股份有限公司入盟 国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟

光力科技股份有限公司于2019年11月入盟国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟。

国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟在国家科技部相关司局和02专项实施管理办公室、总体组的领导下，于2009年12月30日在京成立，由从事集成电路封测产业链制造、开发、科研、教学的25家骨干单位作为发起单位组建而成，成为国家科技重大专项中第一个产业技术创新战略联盟。2010年6月1日被科技部正式确定为开展试点工作的产业技术创新战略联盟。2013年1月15日正式冠名为国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟。联盟目前共有成员单位65家，专家咨询委员会21人。

光力科技主要研发、生产半导体晶圆切割划片机、半导体晶圆研磨机以及自动减薄贴膜机、自动晶圆扩膜机、自动切割贴膜机、自动UV解胶机等辅助设备，入盟国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟后将依托于联盟的技术优势和专家团队，不断提升技术创新能力，将先进封装技术工艺与国际水平接轨，推动设备及材料的国产化进程。

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/153362.html>